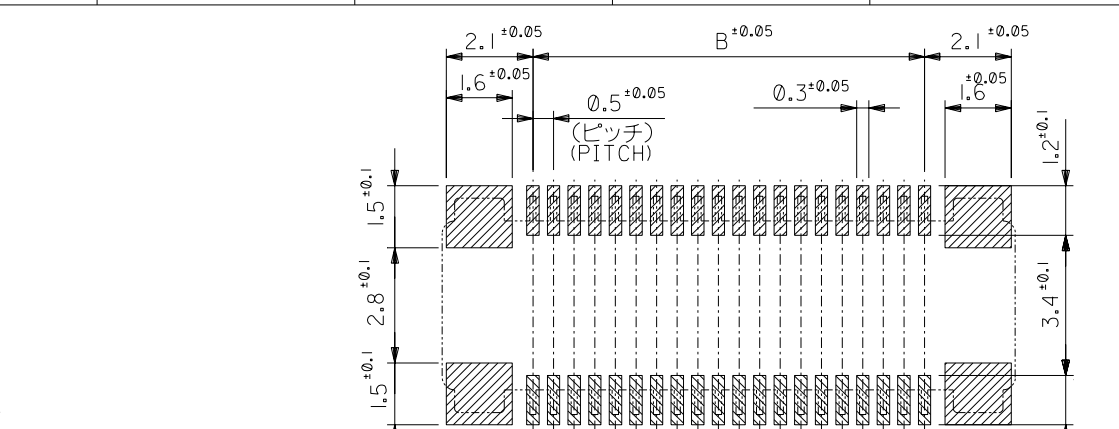
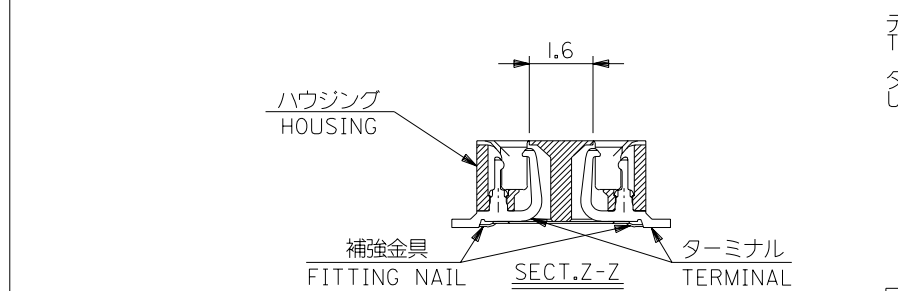
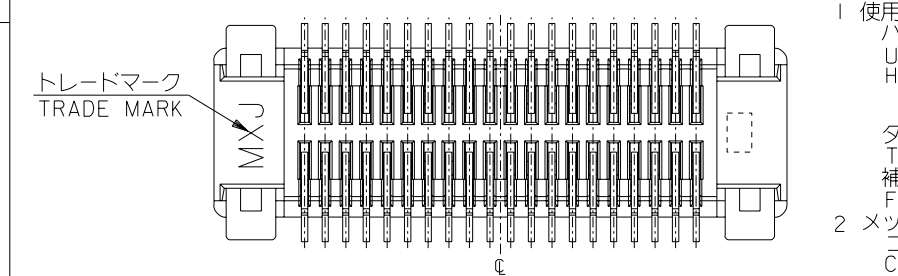
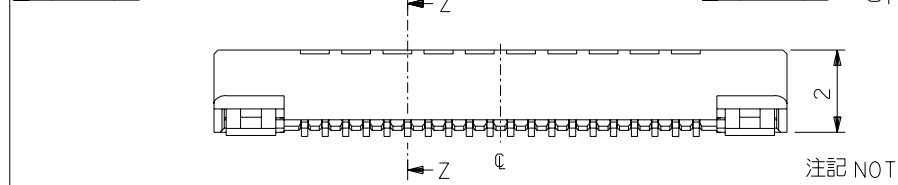
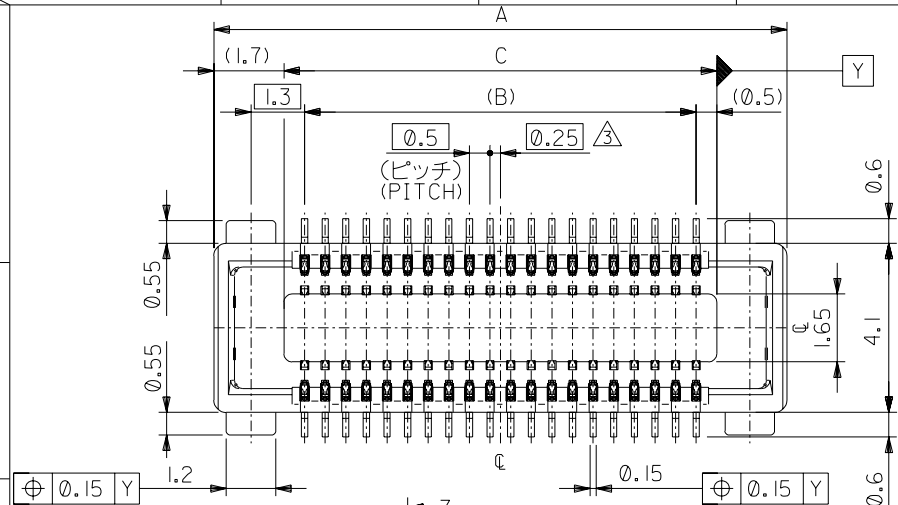


DWC. NO. SD-54150-001

DIMENSIONS IN METRIC DO NOT SCALE DRAWING



参考基板レイアウト (マウント面)
 RECOMMENDED P.C. BOARD
 PATTERN DIMENSION (REF.)
 (MOUNTING AREA)

- 補強金具 : 錫メッキ
 FITTING NAIL : TIN 1.0 MICROMETER MINIMUM
 補強金具下地メッキ : ニッケルメッキ
 UNDER PLATING : NICKEL (FITTING NAIL)
 1.0 MICROMETER MINIMUM
- ③ (全極数/2) = 偶数の場合に適用。
 APPLY FOR (CIRCUIT/2) = EVEN.
- 4 嵌合相手 : 53949 シリーズ
 MATE WITH : 53949 SERIES.
- 5 テール及びネールの平坦度は、 ϕ .IMAX.
 TAIL AND NAIL COPLANARITY TO BE ϕ .IMAX.
- ⑥ テール部に適用。
 APPLY TO THE TAIL AREA.
- ⑦ ネール部に適用。
 APPLY TO THE NAIL AREA.
- 8 本製品は 54150-***1 の鉛フリー品である。
 THIS PRODUCT IS LEAD FREE OF 54150-***1.

注記 NOTES:

- 使用材料 MATERIAL
 ハウジング: ポリフタルアミド (PPA) ガラス充填
 UL94V-0 (黒)
 HOUSING: POLYPHTHAL AMIDE (PPA),
 (GLASS FILLED) UL94V-0
 (COLOR: BLACK)
 ターミナル: リン青銅 (t=0.15)
 TERMINAL: PHOSPHOR BRONZE (t=0.15)
 補強金具: リン青銅 (t=0.2)
 FITTING NAIL: PHOSPHOR BRONZE (t=0.2)
- メッキ仕様 PLATING
 コンタクト部 : 金メッキ
 CONTACT AREA : GOLD
 テール部 : 金メッキ
 TAIL AREA : GOLD
 ターミナル部下地メッキ : ニッケルメッキ
 UNDER PLATING : NICKEL (TERMINAL AREA)

20.5	19.5	23.9	54150-0871	80
18	17	21.4	54150-0771	70
15.5	14.5	18.9	54150-0671	60
13	12	16.4	54150-0571	50

MODEL NO.	54150-***71	C	B	A	MATERIAL NO.	CIRCUIT
-----------	-------------	---	---	---	--------------	---------

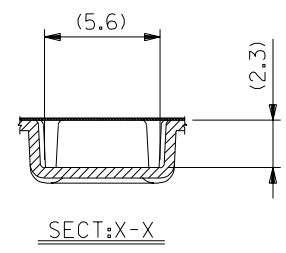
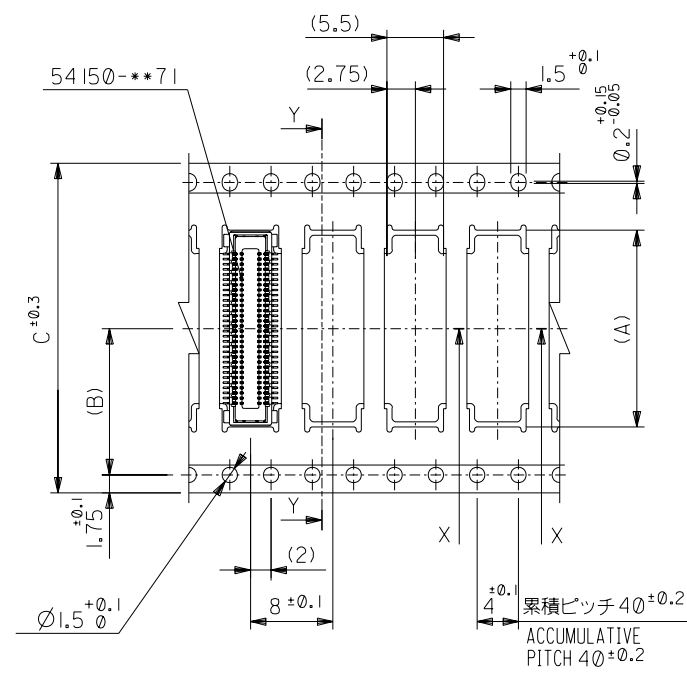
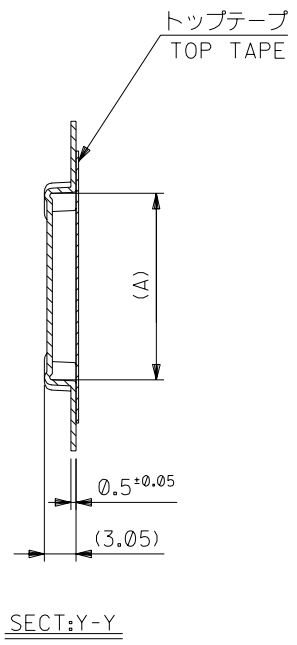
角度 ANGLE		±3°	材料 MATERIAL		注記参照 SEE NOTES		MOLEX-JAPAN CO.,LTD. 日本モレックス株式会社
30°以上 OVER		+0.3	仕上げ FINISH		//		
10°以上 OVER 30° UNDER		+0.25	適用電線範囲 WIRE RANGE		//		TITLE 名称
未満 10° UNDER		+0.2	被覆外径 INS. RANGE		//		0.5 B-To-B Rec Hsg Assy (Hgt=2.5) WITH NAIL -LEAD FREE-
一般公差 GENERAL TOLERANCES		記号 LTR	変更内容 REVISION RECORD	DR. CHK.	日付 DATE	尺度 SCALE	DWG. NO.
		0	新規作成 PROPOSED (J2004-2833)	H.K.	04/03/03	—	SD-54150-001
				M.SASAO	04/03/03		REV
							0

THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX (JAPAN) AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION
 本図面は日本モレックス(株)の所有する情報を含むもので 当社の許可なく複製を禁止する。 EN-01C(032)MXJ-32

DWG. NO. SD-54150-002

MM DIMENSIONS IN METRIC DO NOT SCALE DRAWING

引き出し方向
PULL OUT DIRECTION



32mm幅キャリアテープ
32mm WIDTH CARRIER TAPE

MODEL NO.	54150-***78	32	37.4	33.4	32	14.2	21.6	54150-0778	70
		キャリアテープ幅 CARRIER TAPE WIDTH	E	D	C	(B)	(A)	MATERIAL NO.	種数 CIRCUIT
							19.1	54150-0678	60
							16.6	54150-0578	50

角度 ANGLE	±3°
30以上 OVER	±0.5
10以上 OVER 30 UNDER	±0.25
未満 10 UNDER	±0.2
一般公差 GENERAL TOLERANCES	

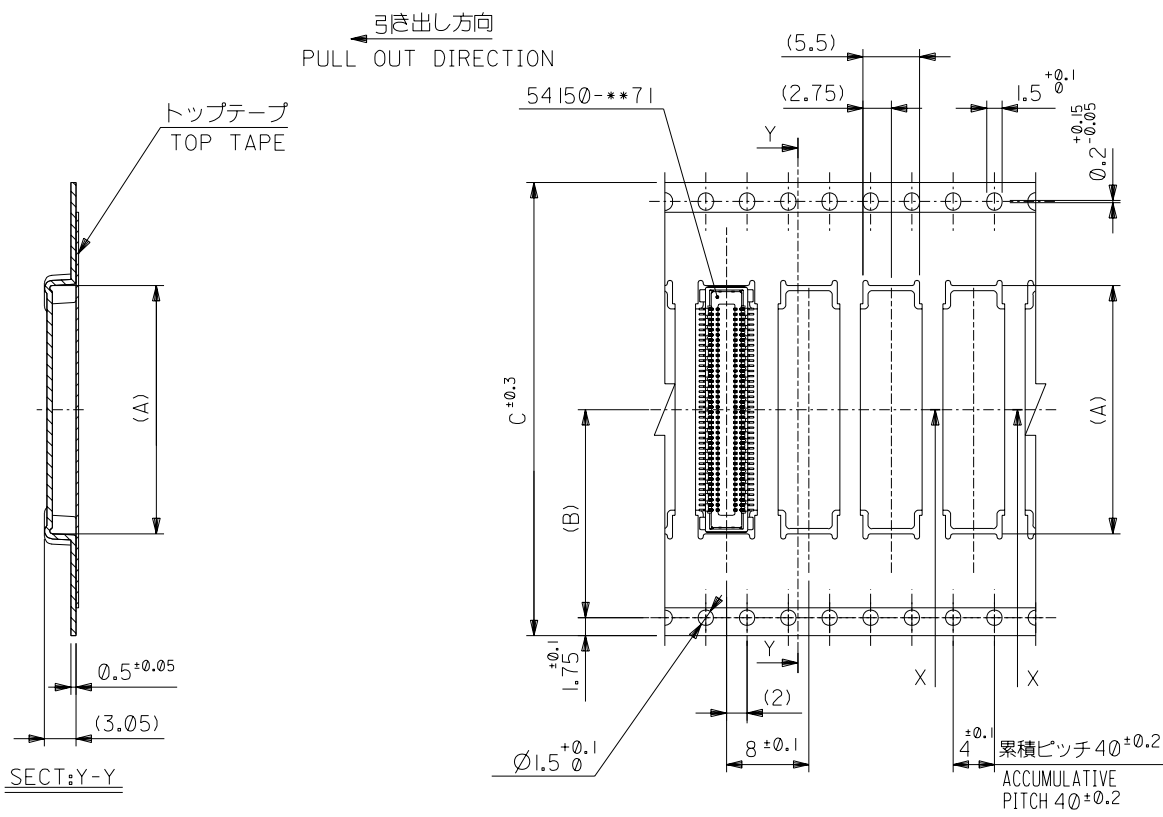
材料 MATERIAL	SHEET 1 OF 3 参照 REFER TO SHEET 1 OF 3	
仕上げ FINISH	— / —	
適用電線範囲 WIRE RANGE	— / —	
被覆外径 INS. RANGE	— / —	
DRAWN BY '04/03/03 H.KAWABATA	CHK'D BY '04/03/03 K.TOJO	
APPR'D BY '04/03/03 M.SASAO	尺 SCALE	— / —

molex MOLEX-JAPAN CO.,LTD. 日本モレックス株式会社	
REVISE ONLY ON CAD SYSTEM	
TITLE 名称 0.5 B-To-B Conn Rec Hsg W/NAIL (Hgt=2.5) Embstp Pkg -LEAD FREE-	
DWG. NO. (SHEET 2 OF 3)	REV
SD-54150-002	0

THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX(JAPAN) AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION
本図面は日本モレックス(株)の所有する情報を含むもので、当社の許可なく複製を禁止する。 EN-01C(032)MXJ-32

DWG. NO. SD-54150-002

MM DIMENSIONS IN METRIC DO NOT SCALE DRAWING



44mm幅キャリアテープ
44mm WIDTH CARRIER TAPE

54150-**78	44	49.4	45.4	44	20.2	24.1	54150-0878	80
MODEL NO.	キャリアテープ幅 CARRIER TAPE WIDTH	E	D	C	(B)	(A)	MATERIAL NO.	種数 CIRCUIT
材料 MATERIAL SHEET 1 OF 3 参照 REFER TO SHEET 1 OF 3							molex MOLEX-JAPAN CO.,LTD. 日本モレックス株式会社	
仕上げ FINISH							REVISE ONLY ON CAD SYSTEM	
適用電線範囲 WIRE RANGE							TITLE 名称 0.5 B-To-B Rec Hsg Assy	
被覆外径 INS. RANGE							W/NAIL (Hgt=2.5) Embstp	
DRAWN BY '04/03/03 H.KAWABATA							CHK'D BY '04/03/03 K.TOJO	
DWG. NO.							(SHEET 3 OF 3) REV	
SD-54150-002							0	

角度 ANGLE	±3°	
30 以上 OVER	±0.5	
10 以上 OVER	30 未満 UNDER	±0.25
未満 10 未満 UNDER	±0.2	
一般公差 GENERAL TOLERANCES		

THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX(JAPAN) AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION
本図面は日本モレックス(株)の所有する情報を含むもので当社の許可なく複製を禁止する。 EN-01C(032)MXJ-32